



會辦單位：

第二層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
<p><b>組員 高玉瑄</b> 0521 1740</p> <p>教授兼任進修 醫推廣部推廣 教育組組長 <b>邱碩志</b> 0521 2154</p> <p><b>秘書 林佑亮</b> 0522 1216</p>		<p>可</p> <p>教授兼任進修 醫推廣部主任 <b>薛敏正</b> 0522 1339</p>

裝

訂

線

檔 號：

保存年限：

## 國立臺北科技大學 函

機關地址：106344臺北市大安區忠孝東路  
三段一號

承辦人：賴建成

電話：2771-2171#6020

電子信箱：lks@ntut.edu.tw

受文者：國立臺北大學

發文日期：中華民國115年5月20日

發文字號：北科大產學字第1157900113號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：AI整合多物理量數位分身人才培育計畫課程表、AI整合多物理量數位分身人才  
培 育 計 畫 課 程 海 報 ( 附 件 1  
A095G0000Q000000\_115F900362\_1\_20094313296.pdf、附件2  
A095G0000Q000000\_115F900362\_2\_20094313296.pdf)

主旨：檢送本校與皮托科技股份有限公司合作辦理115年「AI整  
合多物理量數位分身人才培育計畫」課程資訊（詳如說  
明），敬邀貴校在學學生踴躍報名參加，並請協助公  
告，請查照。

說明：

- 一、課程聚焦於半導體產業中AI、數位分身（Digital Twin）  
與多物理量模擬技術之整合應用，培養具備跨領域分析  
與實務操作能力之專業人才。課程內容涵蓋半導體元件  
物理基礎與模擬軟體操作展示，深入探討半導體封裝之  
電性分析、結構可靠度與壽命特性，並透過半導體製程  
及電漿設備模擬案例，強化學員對製程參數與設備效能  
之理解與應用能力。此外，課程亦延伸至半導體元件與  
封裝之光電特性分析，結合理論、模擬與案例實作，協  
助學員掌握AI驅動之數位分身技術於半導體設計、製  
造、封裝與測試領域中的應用趨勢。
- 二、報名資格：全國公私立各大專校院在學學生。
- 三、課程時間：115年6月6日（六）、6月7日（日），共計2  
天，符合報名資格且全程參與課程者，將於課程結束後



國立臺北大學

第1頁，共4頁  
線上簽核文件列印 - 第3頁/共6頁



1150506103 115/05/20

裝

訂

線

核發研習時數證明電子檔。

四、課程地點：國立臺北科技大學行政大樓9樓國際會議廳、  
Google Meet線上課程。

五、人數上限：實體80人/線上200人。(課程免費)

六、報名時間：即日起至115年6月1日(一)17時為止(如人  
數額滿將提前截止)。

七、報名網址：<https://forms.gle/fFS1bCVLMG84BVic6>

八、聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學  
黃專員，連絡電話：(02)2771-2171分機6023，電子郵件：  
[receivable0308@mail.ntut.edu.tw](mailto:receivable0308@mail.ntut.edu.tw)

九、本課程由本執辦與皮托科技股份有限公司共同合作辦  
理。

十、檢附115年「AI整合多物理量數位分身人才培育計畫」課  
程表、海報。

正本：各公私立大專校院

副本：本校產學處、皮托科技股份有限公司

115/05/20  
10:22:23

裝

線

# 115 年「AI 整合多物理量數位分身人才培育計畫」課程表

課程日期：115 年 6 月 6 日(六) 和 115 年 6 月 7 日(日)

課程地點：1.北科大行政大樓九樓國際會議廳

2.Google Meet 線上課程

報名資格及人數：全國公私立各大專校院在學學生；實體 80 人及 Google Meet 線上 200 人

課程時間：09:00~18:00(報到時間：08:30~9:00，中午休息時間 12:00~13:00)

報名連結：<https://forms.gle/fFS1bCVLMG84BVic6>

課程內容：



日期	時間	課程名稱	課程內容	授課教師	課程地點
6/6 (六)	08:30-09:00	報 到			
	09:00~12:00	AI 整合多物理量數位分身人才培育計畫	半導體元件物理與軟體操作展示	楊棟焜	北科大+Google Meet 線上課程
	13:00-17:00		半導體封裝電性與結構壽命特性		
	17:00~18:00	綜 合 討 論			
6/7 (日)	08:30-09:00	報 到			
	09:00~12:00	AI 整合多物理量數位分身人才培育計畫	半導體製程與電漿設備模擬案例探討	楊棟焜	北科大+Google Meet 線上課程
	13:00-17:00		半導體元件與封裝光電特性分析		
	17:00~18:00	綜 合 討 論			

備註：

1. 成功提交此表單後即可視為報名成功，您填寫的報名資訊也將寄至您填寫前登入之 Gmail 信箱。
2. 若後續因報名資格不符或額滿等因素而無法錄取，主辦單位將另外以 Email 通知。
3. 主辦單位保留報名名額資格審核權，以及修改、變更活動內容及額滿截止報名之權利。

# AI整合多物理量 數位分身人才培育計畫



時間： 115年6月6日(六)、6月7日(日)



地點：國立臺北科技大學



行政大樓九樓 國際會議廳



主辦單位:教育部產學連結辦公室-國立臺北科技大學  
協辦單位:皮托科技股份有限公司

